

高云的产品变更通知 (GPCN)

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此文件是为了提醒客户关注此次变更。此次变更是为了提升 VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049 封装产品的外观质量，对其包装方法进行了变更。

描述

VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049 封装产品的包装方法由托盘包装变更为卷带包装。

变更前	1. 产品包装方法：托盘包装 2. 托盘堆叠层数：10+1 3. 包装数量：490 颗/盘，4900 颗/盒，29400 颗/箱
变更后	1. 产品包装方法：卷带包装 2. 包装数量：3000 颗/卷, 15000 颗/箱

受影响的产品

见附表 1 产品型号清单。

客户影响

因包装方法变更，请客户关注芯片焊接作业流程的变化，避免包装方法变更对生产造成不便。

此变更未涉及产品外形、尺寸、可靠性、质量、安全、功能减少，对客户应用无其他的影响。

认证数据

高云已经完成并成功通过了所有必要的认证，可根据要求提供验证数据。

关键日期

高云将在变更发布后开始在中市场供应卷带包装的产品，托盘包装产品将不再安排生产与供货。

附加文件

附表 1：产品型号清单

序号	产品型号	封装形式
1	GW1N-UV2MG49	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049
2	GW1NR-LV2MG49P	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP
3	GW1NR-UV2MG49P	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP
4	GW1NR-LV2MG49PG	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP
5	GW1NR-UV2MG49PG	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP
6	GW1NR-LV2MG49G	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP
7	GW1NR-UV2MG49G	VFBGA(3.8×3.8-0.5)0049-SIP

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

客户批准

客户名称: _____

授权代表: (签字) _____

批准日期: _____

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2025/06/16	1.0	初始版本。

版权所有 © 2024 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。